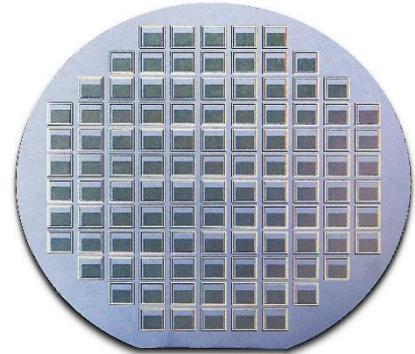


## 红外传感器晶圆级封装窗口晶圆



应用于非制冷红外焦平面探测器晶圆级封装，可显著降低非制冷红外探测器制造成本，提高生产效率。窗口晶圆参数与典型光谱曲线如下：

- 基 材： 硅单晶；
- 尺 寸： 6 英寸或 8 英寸；
- 腔体深度： 100um(可按客户要求定制)
- 光 谱： 垂直入射， $T_{avg} > 80\%$ @8~14 $\mu\text{m}$ ；
- 金 属 化： Ti/Pt/Au 及 AuSn 合金薄膜（金锡比例及薄膜厚度可按客户要求定制）；
- 图 形 化： 红外光学膜及金属化薄膜图形均可按照客户需求定制，可双面定制客户对准标记，图形线宽可达 10 $\mu\text{m}$ 。

